

中国芯片封测行业市场发展分析及项目案例与前景趋势研究报告(2024-2029版)

报告简介

芯片封测是指将通过测试的晶圆,然后按照产品型号和它的功能需求进行加工,之后得到独立芯片的过程。芯片封测是现代化技术的基础,很多的设备都需要用到芯片,比如手机、电脑等,正因为有了这些芯片的组成才会有现在的高科技设备。

封测的技术含量相对较低,国内企业最早以此为切入点进入集成电路产业,近年来,国内封测企业通过外延式扩张获得了良好的产业竞争力,技术实力和销售规模已进入世界第一梯队。在芯片制造产能向大陆转移的大趋势下,大陆封测企业近水楼台,抢占了中国台湾、美国、日韩封测企业的份额。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写,在大量周密的市场调研基础上,主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心提供的最新行业运行数据为基础,验证于与我们建立联系的全国科研机构、行业协会组织的权威统计资料。我们对芯片封测行业进行了长期追踪,结合我们对芯片封测相关企业的调查研究,对我国芯片封测行业发展现状与前景、市场竞争格局与形势、赢利水平与企业发展、投资策略与风险预警、发展趋势与规划建议等进行深入研究,并重点分析了芯片封测行业的前景与风险。报告揭示了芯片封测市场潜在需求与潜在机会,为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据,同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

报告目录

第一章 芯片封测行业相关概述

第一节 半导体的定义和分类

一、半导体的定义

二、半导体的分类

三、半导体的应用

第二节 半导体产业链分析

一、半导体产业链结构

二、半导体产业链流程

三、半导体产业链转移

第三节 芯片封测相关介绍

一、芯片封测概念界定

二、芯片封装基本介绍

三、芯片测试基本原理

四、芯片测试主要分类

五、芯片封测受益的逻辑

第二章 2019-2023年国际芯片封测行业发展状况

第一节 全球芯片封测行业发展分析

一、全球半导体市场发展现状

二、全球封测市场竞争格局

三、全球封装技术演进方向

四、全球封测产业驱动力分析

第二节 日本芯片封测行业发展分析

一、半导体市场发展现状

二、半导体市场发展规模

三、芯片封测企业发展状况

四、芯片封测发展经验借鉴

第三节 中国台湾芯片封测行业发展分析

一、芯片封测市场规模分析

二、芯片封测企业盈利状况

三、芯片封装技术研发进展

四、芯片封测发展经验借鉴

第四节 其他国家芯片封测行业发展分析

一、美国

二、韩国

第三章 2019-2023年中国芯片封测行业发展环境分析

第一节 政策环境

- 一、 智能制造发展战略
- 二、 集成电路相关政策
- 三、 中国制造支持政策
- 四、 智能传感器行动指南
- 五、 产业投资基金支持

第二节 经济环境

- 一、 宏观经济发展现状
- 二、 工业经济运行状况
- 三、 经济转型升级态势
- 四、 未来经济发展展望

第三节 社会环境

- 一、 互联网运行状况
- 二、 可穿戴设备普及
- 三、 研发经费投入增长
- 四、 科技人才队伍壮大

第四节 产业环境

- 一、 集成电路产业链
- 二、 产业销售规模
- 三、 产品产量规模
- 四、 区域分布情况
- 五、 设备发展状况

第四章 2019-2023年中国芯片封测行业发展全面分析

第一节 中国芯片封测行业发展综述

- 一、行业主管部门
- 二、行业发展特征
- 三、行业生命周期
- 四、主要上下游行业
- 五、制约因素分析
- 六、行业利润空间

第二节 2019-2023年中国芯片封测行业运行状况

- 一、市场规模分析
- 二、主要产品分析
- 三、企业类型分析
- 四、企业市场份额
- 五、区域分布占比

第三节 中国芯片封测行业技术分析

- 一、技术发展阶段
- 二、行业技术水平
- 三、产品技术特点

第四节 中国芯片封测行业竞争状况分析

- 一、行业重要地位
- 二、国内市场优势
- 三、核心竞争要素
- 四、行业竞争格局
- 五、竞争力提升策略

第五节 中国芯片封测行业协同创新发展模式分析

- 一、华进模式

二、中芯长电模式

三、协同设计模式

四、联合体模式

五、产学研用协同模式

第五章 2019-2023年中国先进封装技术发展分析

第一节 先进封装技术发展概述

一、一般微电子封装层级

二、先进封装影响意义

三、先进封装发展优势

四、先进封装技术类型

五、先进封装技术特点

第二节 中国先进封装技术市场发展现状

一、先进封装市场规模

二、龙头企业研发进展

三、晶圆级封装技术发展

第三节 先进封装技术未来发展空间预测

一、先进封装前景展望

二、先进封装发展趋势

三、先进封装发展战略

第六章 2019-2023年中国芯片封测行业不同类型市场发展分析

第一节 存储芯片封测行业

一、行业基本介绍

二、行业发展现状

三、企业发展优势

四、项目投产动态

第二节 逻辑芯片封测行业

一、行业基本介绍

二、行业发展现状

三、市场发展潜力

第七章 2019-2023年中国芯片封测行业上游市场发展分析

第一节 2019-2023年封装测试材料市场发展分析

一、封装材料基本介绍

二、封装材料市场规模

三、封装材料发展展望

第二节 2019-2023年封装测试设备市场发展分析

一、封装测试设备主要类型

二、全球封测设备市场规模

三、中国封测设备投资状况

四、封装设备促进因素分析

五、封装设备市场发展机遇

第三节 2019-2023年中国芯片封测材料及设备进出口分析

一、塑封树脂

二、自动贴片机

三、塑封机

四、引线键合装置

五、其他装配封装机器及装置

六、测试仪器及装置

第八章 中国芯片封测行业部分区域发展状况分析

第一节 深圳市

- 一、政策环境分析
- 二、区域发展现状
- 三、项目落地状况

第二节 江西省

- 一、政策环境分析
- 二、区域发展现状
- 三、项目落地状况

第三节 苏州市

- 一、政策环境分析
- 二、市场规模分析
- 三、项目落地状况

第四节 徐州市

- 一、政策环境分析
- 二、区域发展现状
- 三、项目落地状况

第五节 无锡市

- 一、政策环境分析
- 二、区域发展现状
- 三、项目落地状况

第九章 国内外芯片封测行业重点企业经营状况分析

第一节 艾马克技术(amkor technology, inc.)

- 一、企业发展概况
- 二、企业经营状况分析

三、企业发展概况

四、经营效益分析

第二节 日月光半导体制造股份有限公司

一、企业发展概况

二、企业经营状况分析

三、企业发展概况

四、经营效益分析

第三节 京元电子股份有限公司

一、企业发展概况

二、企业经营状况分析

三、企业发展概况

四、经营效益分析

第四节 江苏长电科技股份有限公司

一、企业发展概况

二、经营效益分析

三、财务状况分析

四、经营模式分析

第五节 天水华天科技股份有限公司

一、企业发展概况

二、经营效益分析

三、财务状况分析

四、经营模式分析

第六节 通富微电子股份有限公司

一、企业发展概况

二、企业排名分析

三、经营效益分析

四、财务状况分析

第十章 中国芯片封测行业的投资分析

第一节 芯片封测行业投资背景分析

一、行业投资现状

二、行业投资前景

三、行业投资机会

第二节 芯片封测行业投资壁垒

一、技术壁垒

二、资金壁垒

三、生产管理经验壁垒

四、客户壁垒

五、人才壁垒

六、认证壁垒

第三节 芯片封测行业投资风险

一、市场竞争风险

二、技术进步风险

三、人才流失风险

四、所得税优惠风险

第四节 芯片封测行业投资建议

一、行业投资建议

二、行业竞争策略

第十一章 中国芯片封测产业典型项目投资建设案例深度解析

第一节 通信用高密度集成电路及模块封装项目

- 一、项目基本概述
- 二、投资价值分析
- 三、项目建设用地
- 四、资金需求测算
- 五、经济效益分析

第二节 通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目

- 一、项目基本概述
- 二、投资价值分析
- 三、项目建设用地
- 四、资金需求测算
- 五、经济效益分析

第三节 南京集成电路先进封测产业基地项目

- 一、项目基本概述
- 二、项目实施方式
- 三、建设内容规划
- 四、资金需求测算
- 五、项目投资目的

第四节 光电混合集成电路封测生产线建设项目

- 一、项目基本概述
- 二、投资价值分析
- 三、项目实施单位
- 四、资金需求测算
- 五、经济效益分析

第五节 先进集成电路封装测试扩产项目

- 一、项目基本概述
- 二、项目相关产品
- 三、投资价值分析
- 四、资金需求测算
- 五、经济效益分析
- 六、项目环保情况
- 七、项目投资风险

第十二章 2024-2029年中国芯片封测行业发展前景及趋势预测分析

第一节 中国芯片封测行业发展前景展望

- 一、半导体市场前景展望
- 二、芯片封装行业发展机遇
- 三、芯片封装领域需求提升
- 四、终端应用领域的带动

第二节 中国芯片封测行业发展趋势分析

- 一、封测企业发展趋势
- 二、封装技术发展方向
- 三、封装技术发展趋势
- 四、封装行业发展方向

第三节 2024-2029年中国芯片封测行业预测分析

- 一、2024-2029年中国芯片封测行业影响因素分析
- 二、2024-2029年中国芯片封测行业销售额预测

图表目录

图表：芯片封测市场产品构成图

图表：芯片封测市场生命周期示意图

图表：芯片封测市场产销规模对比

图表：芯片封测市场企业竞争格局

图表：2019-2023年中国芯片封测市场规模

图表：2019-2023年我国芯片封测供应情况

图表：2019-2023年我国芯片封测需求情况

图表：2024-2029年中国芯片封测市场规模预测

图表：2024-2029年我国芯片封测供应情况预测

图表：2024-2029年我国芯片封测需求情况预测

图表：芯片封测市场企业市场占有率对比

图表：2019-2023年芯片封测市场投资规模

图表：2024-2029年芯片封测市场投资规模预测

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费) Email : kf@51baogao.cn

本文地址 : <https://www.51baogao.cn/baogao/20230614/444976.shtml>

在线订购 : [点击这里](#)